

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-016

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 关于同美国高通公司签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）近日同美国Qualcomm Inc. 及其子公司（以下简称“高通公司”）签署《Components Supply Agreement》、《Master Software Agreement》、《Provisional AMSS8909 software addendum to Master Software Agreement》、《Provisional AMSS8996 software addendum to Master Software Agreement》（以下统称“《合作协议》”），现将相关情况公告如下：

一、交易对方基本情况

公司名称：高通公司

成立日期：1985年7月

注册地点：美国特拉华州

执行董事长：Paul E. Jacobs 博士

公司住所：美国加利福尼亚州圣迭戈市 5775 Morehouse Drive

主营业务：3G、4G芯片组、系统软件以及开发工具和产品，技术许可的授予，BREW应用开发平台，QChat、BREWChatVoIP解决方案技术，QPoint定位解决方案，Eudora电子邮件软件，包括双向数据通信系统、无线咨询及网络管理服务等的全面无线解决方案，MediaFLO系统和GSM1x技术等。

高通公司同公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

1、公司从Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd（高通公司子公司）采购ASIC、多芯片模块、SiP产品、SoC产品等,应用到公司相关产品中；

2、公司获得授权使用高通公司Advanced Mobile Subscriber Station Software、Application Processor Software、Dual Mode Subscriber Software以及其他选择性软件，应用到公司相关软件开发中；

3、公司同高通公司就应用AMSS8996、AMSS8909及其ASIC芯片签署补充协议，确定AMSS8996、AMSS8909使用规范。

三、协议签署对公司的影响

高通公司作为全球第一大无线芯片厂商，同其签署合作协议有助于保证公司移动虚拟现实产品芯片供应。同高通公司合作进行ASIC软件开发，有助于公司在底层软件协议基础上进行软件再开发，建立虚拟现实硬件、软件系统集成解决方案，为客户提供基于高通骁龙820芯片的移动虚拟现实产品,有助于巩固公司在全球虚拟现实硬件制造领域的领先地位，并在移动虚拟现实一体机方面形成新的竞争优势。

四、本意向性协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、备查文件

1、《Components Supply Agreement》；

2、《Master Software Agreement》；

3、《Provisional AMSS8909 software addendum to Master Software Agreement》；

4、《Provisional AMSS8996 software addendum to Master Software Agreement》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日